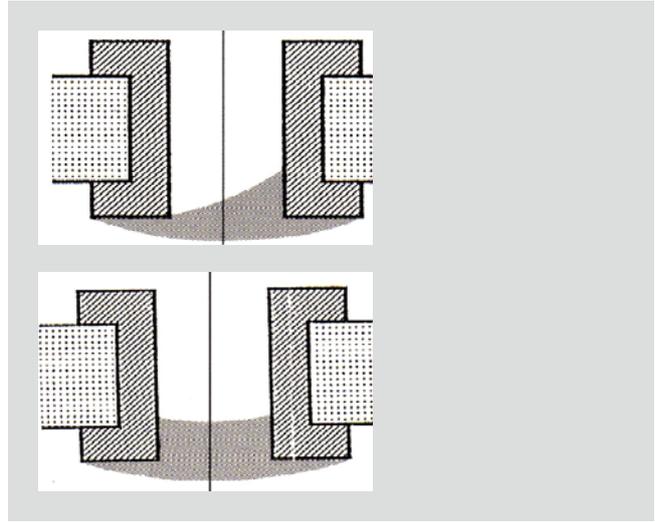


【起因・判断ポイント・発生工程】フラックス未塗布、異物付着、はんだ上げ条件不適などにより出来たもの（はんだ上げ試験）

【原因、判断要点、発生工序】未塗布助焊剤、附着雑物、爬錫条件不合适等所造成的（可焊性测试）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by the absence of flux, the presence of a foreign object or improper soldering condition (Solderability test)



9-1-3 ランド舐めはんだ／焊环的吸锡 / Solder only on through-hole land

【特徴】はんだがスルーホールランド部にしか付いていない状態の欠陥

【特征】焊料只附着在焊环的缺陷。

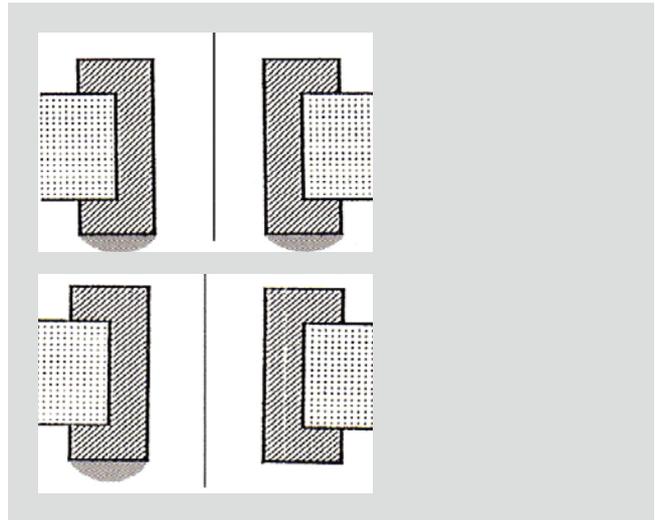
【Characteristics】 Only the land of a PTH is soldered.

【起因・判断ポイント・発生工程】フラックス未塗布、異物付着、はんだ上げ条件不適などにより出来たもの（はんだ上げ試験）

【原因、判断要点、発生工序】未塗布助焊剤、附着雑物、爬錫条件不合适等所造成的（可焊性测试）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by the absence of flux to a PTH, the presence of a foreign object or improper soldering condition (Solderability test)

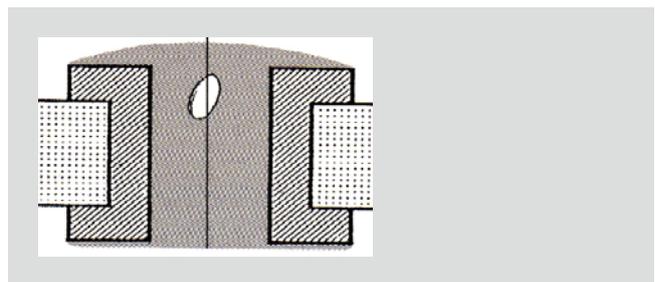


9-1-4 ブローホールはんだ／焊料有气孔 / Solder joint with blow hole

【特徴】はんだの中や、スルーホールの入り口部のはんだに空洞が出来ている状態の欠陥

【特征】在焊料中或者通孔入口的焊料有空洞的缺陷。

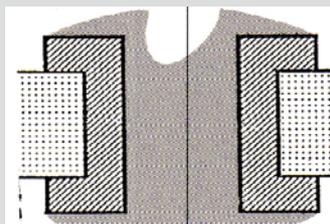
【Characteristics】 A void exists inside or on the surface of the filled solder to a PTH.



【起因・判断ポイント・発生工程】はんだ中の異物や気泡の介在、はんだ上げ条件不適などにより出来たもの（はんだ上げ試験）

【原因、判断要点、発生工序】焊料中夹杂杂物或者气泡、爬锡条件不合适等所造成的（可焊性测试）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
The defect is caused by the presence of a foreign object, a bubble in solder or improper soldering condition (Solderability test)



回路欠陥

S/R欠陥

シンボルマーク欠陥

めっき欠陥

スルーホール欠陥

機械加工欠陥

その他欠陥

信頼性不足

はんだ上がり欠陥

電子部品のはんだ欠陥